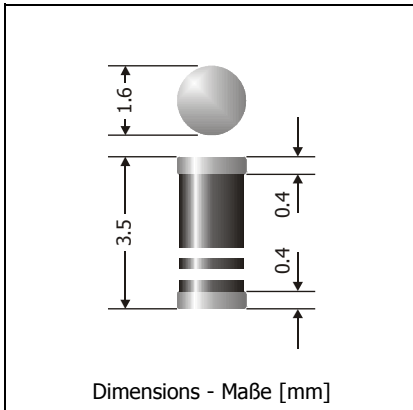



## EGL34A ... EGL34G

### Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers Superschnelle Si-Gleichrichter für die Oberflächenmontage

Version 2007-04-05



Nominal current – Nennstrom	0.5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...400 V
Plastic case MiniMELF Kunststoffgehäuse MiniMELF	DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

- Marking:            1. green ring denotes "cathode" and "superfast switching rectifier family"  
                         2. colored ring denotes "repetitive peak reverse voltage" (see below)
- Kennzeichnung:    1. grüner Ring kennzeichnet "Kathode" und "superschnelle Gleichrichter"  
                         2. farbiger Ring kennzeichnet "Periodische Spitzensperrspannung" (siehe unten)

#### Maximum ratings

#### Grenzwerte

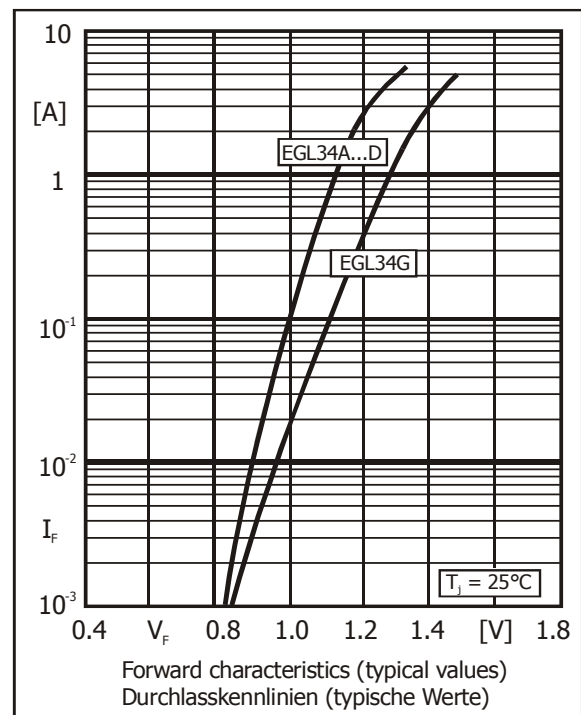
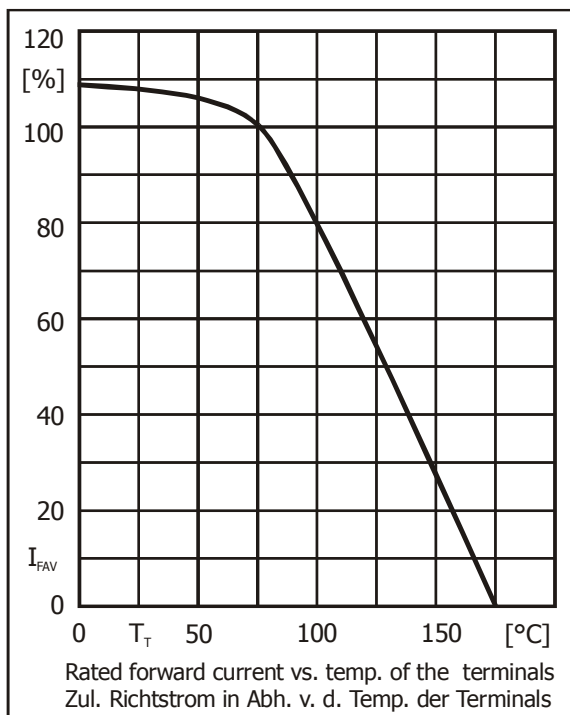
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	2. Cathode ring 2. Kathodenring
EGL34A	50	50	gray / grau
EGL34B	100	100	red / rot
EGL34D	200	200	orange / orange
EGL34G	400	400	yellow / gelb

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 75^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	0.5 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	2 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	8.5/10 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	0.5 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	-50...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	-50...+175°C

**Characteristics**
**Kennwerte**

Type Typ	Reverse recovery time Sperrverzugszeit	Forward voltage Durchlass-Spannung		
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$t_{rr} [\text{ns}]^1)$	$V_F [\text{V}]$	at / bei $I_F = [\text{A}]$
EGL34A ... EGL34D		< 50	< 1.25	0.5
EGL34G		< 50	< 1.35	0.5

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 5 $\mu\text{A}$
	$T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 50 $\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 150 $\text{K/W}^2)$
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss			$R_{thT}$	< 70 $\text{K/W}$



- $I_F = 0.5 \text{ A}$  through/über  $I_R = 1 \text{ A}$  to/auf  $I_R = 0.25 \text{ A}$
- Mounted on P.C. board with 25  $\text{mm}^2$  copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25  $\text{mm}^2$  Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss